



平成 30 年 7 月 31 日

各 位

上場会社名 株式会社和井田製作所  
代表者名 代表取締役会長兼社長 和井田光生  
(コード番号 6158)  
問合せ先責任者 取締役経営企画部長 森下 博  
(TEL 0577-32-0390)

### 半導体ウェーハ平面研削盤の量産機開発の凍結に関するお知らせ

当社は、このたび、半導体ウェーハ平面研削盤の量産機開発の凍結を決定しましたのでお知らせします。

新たな市場分野向けの製品である半導体ウェーハ平面研削盤について、SiC ウェーハ関連メーカー各社から一定の評価をいただいていたことから、量産機の開発を進めるなど積極的に取り組んでまいりました。

しかしながら、既存の市場分野においてシェア拡大をめざした海外戦略等が順調に進展していることから、経営リソースを既存市場に集中させるため、この度、量産機の開発を凍結することといたしました。

なお、本件による、当社の平成 31 年 3 月期における当社連結及び単体の業績に与える影響は軽微です。

以 上